



## DICING EQUIPMENT



# 7900/20/30

## AUTOMATIC TWIN



ADT 7900シリーズには、ウェーハまたはパッケージを高スループットで同時にダイシングできる2つの対向スピンドルがあります。  
ADT 7900シリーズは、製品を高性能かつ低コストでダイシングできる高精度システムです。

### 基本的なマシンモデル:

- ・7900 デュオサポート Ø8 インチ
- ・最大 10"×10"の 7920 デュオ
- ・最大 12"×10"または Ø12"の 7930 デュオ

### 特徴と利点

- ・素早いブレード交換
- ・SECS / GEM プラットフォーム対応
- ・メンテナンスが容易なシステムのあらゆる領域へのフルアクセス
- ・エアベアリング送り軸(X)
- ・スループット向上のための高速自動アライメントとカットポジショニング

仕 様		7900 Duo	7920 Duo	7930 Duo
ワークサイズ		Φ8"	10"×10"	12"×10"又はΦ12"
スピンドル		対面型 1.8kw又は2.2kwシャフトロックスピンドル、max.60,000rpm		
ブレードサイズ		2"-3"		
Y1/Y2軸	制御	両Y軸共リニアエンコーダ		
	分解能	0.1 μm		
	累積精度	1.5 μm		
	送り精度	1.0 μm		
X軸		エアスライド		
Z1/Z2軸	分解能	0.2 μm		
	再現性	1.0 μm		
	ストローク	30mm(ブレード外径2.188")		
θ軸	再現性	4アーク秒		
	ストローク	350°		
用力	電気	200-240VAC、50/60Hz、単相		
寸法 (WxDxH)mm		875x975x1450		
	重量	900kg		

注:仕様は予告なく変更される場合があります。

# 8020

## FULLY AUTOMATIC 8" TWIN



ADT 8020 ダイシングシステムには、ウェーハを高スループットで同時にダイシングできる2つの向かい合ったスピンドルがあります。ADT 8020 は、高精度のシステムです。

直径 8 インチまでの製品を、高性能かつ低コストでダイシングできます。

### 特徴と利点

- ・柔軟性-最大外径 3 インチのハブおよびハブレスブレードをサポートします。
- ・1.8kW または 2.2kW の高出力のスピンドル
- ・大型 19 インチタッチスクリーンモニターを使用した直感的な操作インターフェース
- ・ロッキングスピンドルシャフトによる高速で簡単なブレード交換
- ・SECS / GEM プラットフォーム対応

仕 様		8020
ワークサイズ*		Φ8" 10" × 10" 12" × 10" 又は Φ12"
スピンドル		対面型 1.8kw又は2.2kwシヤフトロックスピンドル、max.60,000rpm
ブレードサイズ*		2"-3"
Y1/Y2軸	制御	両Y軸共リニアエンコーダ
	分解能	0.1 μm
	累積精度	1.5 μm
	送り精度	1.0 μm
	切削範囲	210mm
X軸		エアースライド*
Z1/Z2軸	分解能	0.2 μm
	再現性	1.0 μm
	ストローク	30mm(ブレード外径2.188")
θ軸	再現性	47-ク秒
	ストローク	380°
洗浄ステーション		完全リンス&乾燥サイクル
	回転スピード*	100-3,000rpm
	洗浄方法	噴霧洗浄機能
用力	電気	200-240VAC、50/60Hz、単相
寸法 (WxDxH)mm		875x975x1450
	重量	900kg

注:仕様は予告なく変更される場合があります。

# 8030

## FULLY AUTOMATIC 12" TWIN



ADT 8030 ダイシングシステムには、ウェーハを高スループットで同時にダイシングできる2つの対向するスピンドルがあります。ADT 8030 は、最大直径 12 インチまたは 12 インチ×12 インチの製品を高性能かつ低コストでダイシングできる高精度システムです。

### 特徴と利点

- ・柔軟性-最大外径 3 インチのハブおよびハブレスブレードをサポートします。
- ・1.8kW または 2.2kW の高出力のスピンドル
- ・効率的なウェーハ加工をサポートするブリッジタイプのフレーム
- ・大型 19 インチタッチスクリーンモニターを使用した直感的な操作インターフェース
- ・ロッキングスピンドルシャフトによる高速で簡単なブレード交換
- ・SECS / GEM プラットフォーム対応

仕 様		8030
ワークサイズ*		Φ8"、Φ12"又は12"×12"角
スピンドル		対面型 1.8kw又は2.2kwシャフトロックスピンドル、max.60,000rpm
プレートサイズ*		2"-3"
Y1/Y2軸	制御	両Y軸共リアエンコーダ*
	分解能	0.1 μm
	累積精度	1.5 μm
	送り精度	1.0 μm
	切削範囲	350mm
X軸		エアースライド*
Z1/Z2軸	分解能	0.2 μm
	再現性	1.0 μm
	ストローク	50mm(プレート*外径2.188")
θ 軸	再現性	4アーク秒
	ストローク	380°
洗浄ステーション		完全リンス&乾燥サイクル
	回転スピード*	100-3,000rpm
	洗浄方法	噴霧洗浄機能
用力	電気	200-240VAC、50/60Hz、単相
寸法 (WxDxH) mm		1,145×1,687×1,830
重量		1,500kg

注:仕様は予告なく変更される場合があります。

# 72xx FULLY AUTOMATIC DICING SYSTEM



7200 システムは、お客様のスループットと品質の要件を満たすために、高度な自動化とプロセス監視の幅広いオプションを提供します。

最も困難なダイシングアプリケーション: シリコン、シリコン上のガラス、ガラス、BGA および QFN パッケージ、LTCC、セラミック、PCB、およびその他の硬質材料アプリケーション。

## 特徴と利点

- ・効率的なウェーハハンドリングシステム
- ・連続デジタル倍率ビジョンシステム
- ・ブレード摩耗予測アルゴリズムにより、高さ測定時間が短縮され、UPH が増加します
- ・優れたプロセス結果を実現するアトマイズウェーハ洗浄技術

仕 様		7222	7223	7224	7200-300 2"	7200-300 2"
ワークサイズ*		Φ8"			Φ12又は253mmX243mm	
スピンドル		60K rpm/1.8kw		30Krpm/2.5kw	60Krpm/1.8kw	
ブレードサイズ*		2"-3"		4"-5"	2"-3"	4"-5"
Y軸	制御	リニアエンコーダ*				
	分解能	0.1 μm				
	累積精度	1.5 μm				
	送り精度	1.0 μm				
X軸		エアースライド*				
Z軸	分解能	0.2 μm				
	再現性	1.0 μm				
θ 軸	再現性	47-ク秒				
	ストローク	350°				
洗浄ステーション		完全リンス&乾燥サイクル				
	回転スピード*	100-3,000rpm				
	洗浄方法	噴霧洗浄機能				
用力	電気	200-240VAC、50/60Hz、単相				
寸法 (WxDxH)mm		965x1,460x1,700			1,100x1,785x1,700	
	重量	1,200kg			1,350kg	

注: 仕様は予告なく変更される場合があります。

# 71TS 2" TILTED SPINDLE



傾斜スピンドルダイシングシステムは、光ファイバーコンポーネントの後方反射を抑制するために必要な垂直カットと8° 角度カットの両方を提供することにより、オプトエレクトロニクスコンポーネントメーカーのニーズを満たすように設計されています。このシステムは、垂直(0° )から最大 15° の任意の角度への迅速な切り替えを提供します。

## 代表的なアプリケーション

- ・シリコン、シリコンオンシリコン
- ・ポリマーオン Si
- ・InP
- ・GaAs
- ・ファイバーウェーブガイド
- ・LiNbO3
- ・フェーズドシリカ

仕様		71TS
ワークサイズ*		Φ8"
スピンドル		60K rpm/1.8kw
プレートサイズ*		2"-3"
特長		2つの角度を提供:
		第1角度:0° C
		第2角度:0° C-15° C (傾斜角)
		微調整角度調整機能
Y軸	制御	リニアエンコーダ*
	分解能	0.1 μm
	累積精度	1.5 μm
	送り精度	1.0 μm
X軸		エアースライド*
Z軸	分解能	0.2 μm
	再現性	1.0 μm
θ 軸	再現性	47-ク秒
	ストローク	350°
用力	電気	200-240VAC、50/60Hz、単相
寸法 (WxDxH)mm		965x1,300x1,600
重量		900kg

注:仕様は予告なく変更される場合があります。

# 71MD 2" DICING SYSTEM FOR MEDICAL



71MD ダイシングシステムは、PZTなどの要求の厳しいタイトなアプリケーション向けに設計されています。このシステムには、部品測定システムの高さが装備されており、大きなZクリアランスを提供できます。また、超音波センサーアプリケーションで一般的なスピンドルの振動を最小限に抑えるためのバランスツールを提供することもできます。

## 特徴と利点

- ・マルチパネルハンドリング
- ・カスタムジグ
- ・幾何学的モデルファインダー(GMF)
- ・大きなZクリアランス
- ・低振動スピンドル
- ・高解像度水流クーラント
- ・Zリニアエンコーダ
- ・高さ測定ツール(HMT)

仕様		71MD
ワークサイズ		Φ8"
スピンドル		60K rpm/1.8kw
ブレードサイズ		2"-3"
特長		Z軸リニアエンコーダ
		Z軸空間距離
		ワーク上での高さ測定
		GMF: 幾何学的モデル検出
Y軸	制御	リニアエンコーダ
	分解能	0.1 μm
	累積精度	1.5 μm
	送り精度	1.0 μm
X軸		エアースライト
Z軸	分解能	0.2 μm
	再現性	1.0 μm
θ軸	再現性	47-ク秒
	ストローク	350°
用力	電気	200-240VAC、50/60Hz、単相
寸法 (WxDxH)mm		965x1,300x1,600
	重量	900kg

注:仕様は予告なく変更される場合があります。

# 71xx 2" AND 4" SPINDLE DICING SYSTEM



2インチおよび4インチのスピンドルダイシングシステムの7120/7130ファミリーは、ニーズをサポートするための高レベルの手頃な価格と柔軟性を提供します。

## 特徴と利点

- ・2"-3"および4"-5"ブレード外径をサポート大きな「Z」ストローク
- ・スムーズな動きとスーパーカット品質のための「X」軸エアベアリング
- ・高解像度光学系による自動化
- ・マルチパネルダイシング
- ・カスタムプロセスソリューション
- ・ロッキングスピンドルシャフト(2インチスピンドル用)による高速で簡単なブレード交換

仕様		7122	7124	7132	7134
ワークサイズ*		Φ8"		Φ12又は300mmX300mm W/O frame	
スピンドル		60K rpm/1.8kw	30K rpm/2.5kw	60Krpm/1.8kw	30K rpm/2.5kw
ブレードサイズ*		2"-3"	4"-5"	2"-3"	4"-5"
Y軸	制御	リニアエンコーダ*			
	分解能	0.1 μm			
	累積精度	1.5 μm			
	送り精度	1.0 μm			
X軸		エアースライド*			
Z軸	分解能	0.2 μm			
	再現性	1.0 μm			
θ軸	再現性	47-ク秒			
	ストローク	350°			
用力	電気	200-240VAC、50/60Hz、単相			
寸法 (WxDxH)mm		965x1,300x1,600			
重量		900kg			

注:仕様は予告なく変更される場合があります。

\* 24"×18"をカバーする2"および4"スピンドルで利用可能な特別な7100XLA